

芯片尺寸封装



[芯片尺寸封装_下载链接1](#)

著者:贾松良

出版者:清华大学出版社

出版时间:2003-10

装帧:平装

isbn:9787302073765

芯片尺寸封装（CSP）是20世纪90年代初兴起的一种高封装效率的IC封装，其封装尺寸小、封装实体薄，多数具有阵列式排式的引出端，便于测试、老炼和表面安装式组装，

非常适合于便携式、高密度或高频电子器件的封装。本书全面介绍了四大类40多种不同结构的芯片尺寸封装，说明了每种封装的设计原理、封装结构、材料、制造工艺、性能、可靠性及应用。本书可作为从事芯片尺寸封装的研究、文教使用人员的参考书，也可作为相关专业高等院校高年级和研究生的参考书。

作者介绍:

目录: 第1篇 用于CSP的倒装芯片和引线键合

第1章 CSP基板上焊凸点倒装芯片和引线键合芯片的比较

1.1 引言

1.2 焊凸点倒装芯片与引线键合的成本分析

1.2.1 组装工艺

1.2.2

• • • • • ([收起](#))

[芯片尺寸封装_下载链接1](#)

标签

专业

评论

[芯片尺寸封装_下载链接1](#)

书评

[芯片尺寸封装_下载链接1](#)